证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2023-007

广东安达智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]400 号)，公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为 1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,764,789.64 元后，公司实际募集资金净额为 1,119,801,236.67 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-35 号)。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	111,980.12
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	18,762.72
	利息收入净额	C2	1,565.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,762.72
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,565.87
应结余募集资金		E=A-D1+D2	94,783.27
实际结余募集资金		F	50,883.25
差异		G=E-F	43,900.02

注:差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 43,900 万元及支付手续费 0.02 万元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2022 年 4 月 13 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额如下：

单位:人民币 元

开户行名称	银行账号	活期存款余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	405,690,821.59
广发银行东莞华发支行	9550880202032500111	102,287,573.27
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	167,710.99
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	642,590.48
招商银行东莞中集智谷支行	769905743910908	43,811.47
合计	–	508,832,507.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 18,762.72 万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表 1:募集资金使用情况对照表”

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金 4,222.83 万元及已支付发行费用的自筹资金 234.33 万元(不含增值税)。合计使用募集资金人民币 4,457.16 万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕7-450 号)。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-007)。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金均已全部完成置换。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

根据前述审议情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	认购金额(万元)	产品名称	资金来源	起始日	到期日	产品类型及年化收益率
1	华夏银行东莞东城支行	5,800	大额存单	募集资金	2022-11-14	2023-11-13	保本固定收益型 2.90%
2	华夏银行东莞东城支行	12,100	大额存单	募集资金	2022-11-14	2023-11-13	保本固定收益型 2.90%
3	广发银行东莞华发支行	26,000	“物华添宝”G 款 2022 年第 171 期人民币结构性存款(挂钩沪金 2304 合约看涨阶梯式结构)(机构版)	募集资金	2022-11-29	2023-2-27	保本浮动收益型 1.3% 或 3.05% 或 3.1%
合计		43,900	/	/	/	/	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募投项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(九)募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金的金额：

2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额少于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的计划投入的募集资金金额，故同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	流体设备及智能组装设备生产建设项目	78,670.98	78,670.98	75,683.62
2	研发中心建设项目	16,078.01	16,078.01	16,078.01
3	信息化建设项目	6,294.97	6,294.97	6,294.97
4	补充流动资金项目	16,000.00	16,000.00	13,923.52
合计		117,043.96	117,043.96	111,908.12

独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-006)。

2、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

2022 年 12 月 6 日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户：

开户银行	账户名称	账号
中国农业银行东莞寮步香市路支行	广东安达智能装备股份有限公司	44289401040010250

上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位:人民币万元

募集资金总额				111,980.12		本年度投入募集资金总额						18,762.73		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						18,762.73		
变更用途的募集资金总额比例				0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
流体设备及智能组装设备生产建设项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	242.73	242.73	−75,440.89	0.32	2024 年 12 月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	否	16,078.01	16,078.01	16,078.01	4,053.16	4,053.16	−12,024.85	25.21	2024 年 12 月	不适用	不适用	否		
信息化建设项目	否	6,294.97	6,294.97	6,294.97	543.31	543.31	−5,751.66	8.63	2024 年 12 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	否	16,000.00	13,923.52	13,923.52	13,923.52	13,923.52		100.00	不适用		不适用	不适用	否	
合计		117,043.96	111,980.12	111,980.12	18,762.72	18,762.72	−93,217.40	–	–			–	–	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2022 年 5 月 12 日于召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,222.83 万元及已支付发行费用的自筹资金 234.33 万元(不含增值税)。合计使用募集资金人民币 4457.16 万元置换预先投入的自筹资金。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，并于到期日前归还至募集资金专项账户。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				不适用										

公司代码:688125　　公司简称:安达智能

广东安达智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本 80,808,080 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,404,040.00 元(含税)。2022 年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润 157,113,932.79 元的比例为 25.72%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	易伟桃	袁菊红
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号	广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
电话	0769-38851180	0769-38851180
电子信箱	yiweitao@anda-dg.com	caiwu@anda-dg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造设备的研发、生产和销售，产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉、组装机及 ADA 智能平台等在内的多种智能制造装备，可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。

历经多年发展和技术积累，公司围绕智能制造装备积累了包括高精度点胶技术在内的 16 项核心技术，已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球电子头部客户及其 EMS 电子信息产业链客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业，2009 年推出选择性涂覆机，2010 年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机”，随后相继推出包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备及核心零部件，形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

(1)流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、喷墨机和灌胶机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的 SMT 电子装联、FATP 后段组装的点胶和 TP 触摸屏涂覆等，以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
点胶机	AD 系列	AD-H智能点胶机	1.用途:用于包括消费电子产品在内的 SMT 段点胶，包括点红胶、底部填充、零件包覆、IC 补强等工序。 2.主要参数:X/Y/Z 轴精度可达 0.01mm，重复精度可达 0.01mm;最大移动速度可达 1500mm/s。 3.产品特点:XY 轴采用直线电机，运动精度更高;集成 CCD 视觉系统，可分配胶量、抓拍轨迹、扫描条码;可选配双阀同步点胶。
		AD16-8D双工位全自动点胶机	1.用途:用于半导体产品封装点胶，包括 IC 点围坝胶、封装、零件包覆、芯片底部填充等。 2.主要参数:X/Y 重复精度可达 0.005mm;最大移动速度可达 1300mm/s，最大加速度 1.5G。 3.产品特点:带洁净送风单元，满足半导体加工洁净度要求;铸造结构可减少设备晃动;采用双层往复式上下料方式;搭配 AOI 检测及定位功能及激光高度检测系统，实现整机精度检验。
	ijet 系列	ijet-H智能点胶机	1.用途:用于电气元器件底部填充、引脚包边、表面贴装点胶等工序。 2.主要参数:X/Y 重复精度可达 0.01mm;最大移动速度可达 1000mm/s，最大加速度 1.5G。 3.产品特点:可根据工艺需求，选配双轨双阀或单轨双阀结构，点胶行程最大可达 400mm;可实现四方位倾斜，可选配增压泵、激光测高系统等。
		ijet-H智能点胶机	1.用途:热熔胶粘接、底部填充，引脚包封、堆栈封装 POP、围坝与填充、点红胶、FPC 元器件补强等。 2. 主要参数：重复精度 ±0.015，最大移动速度 1200mm/S。 3.产品特点:(1)设备为在线式点胶设备;(2)采用直线电机 + 运动控制卡;(3)可直接导入任何品牌的贴片机文件，也可在线视觉编程;(4)可选配激光高度检测系统，工件变形后可自动校准 Z 轴高度;(5)可选配精密测重系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性;(6)可选拓展工艺模块丰富，满足客户不同点胶工艺需求。
	TSV 桌面点胶系列	TSV-300Plus 桌面点胶机	1.用途:热熔胶粘接、底部填充，引脚包封、堆栈封装 POP、围坝与填充、点红胶、FPC 元器件补强等。 2. 主要参数：重复精度 ±0.025，最大移动速度 800mm/S。 3.产品特点:设备为离线式点胶设备、桌面点胶设备，占地空间较小，采用线性模组 + 伺服电机驱动。
	ADG 系列	AD8-5D 五轴桌面点胶机	1.用途:热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装 POP、围坝与填充、点红胶、FPC 元器件补强等。 2. 主要参数：重复精度 ±0.012，最大移动速度 1000mm/S。 3.产品特点:(1)设备为在线式点胶设备;(2)采用直线电机 + 运动控制卡;(3)使用五轴跳动控制技术，可实现产品空间任意点胶轨迹需求;(4)可直接导入任何品牌的贴片机文件，也可在线视觉编程;(5)可选配激光高度检测系统，工件变形后可自动校准 Z 轴高度;(6)可选配精密测重系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性;(7)可选拓展工艺模块丰富，满足客户不同点胶工艺需求。
涂覆机	iCoat 系列	iCoat-3 高精度涂覆机	1.用途:适用于多行业涂覆应用，可进行多拼版的涂覆，满足客户高产能需求;可进行制程工艺多样的大面积选择性涂覆。 2. 主要参数：重复精度 0.02mm；最大移动速度 800mm/s，X/Y 轴行程最大可达 450mm。 3.产品特点:可根据工艺需求，选择多种行程规格的设备;可配备多种阀体，进行多阀排列，适应多样拼板生产需求。
		iCoat-5 高精度涂覆机	1.用途:对电子元器件和引脚等进行精确选择性涂覆，提升对电子元器件保护强度。 2. 主要参数：重复精度 0.02mm；最大移动速度 800mm/s;传输速度 2~13m/min。 3.产品特点:可进行多方位多角度喷涂，解决高精度零件死角喷涂问题。

(2)等离子设备

等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机，用于清洗 FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。

产品系列	典型产品图示	产品性能
VP 系列	VP-10L在线式真空等离子清洗机	1.用途:清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物，提高表面附着力。 2.主要参数:可实现程序温控清洗，温度最低至40度;抽真空时间15秒，破真空时间5秒，水汽角度最小可达10°。 3.产品特性:在线式清洗，全方位低温表面清洗，异向等离子体可以进入极细狭缝清洗。
	VP-80系列全自动离线式等离子清洗机	1.用途:清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物，提高表面附着力。 2.主要参数:可实现程序温控清洗，温度最低至40度;射频功率0-500W可调节。 3.产品特性:真空腔体采用铝合金制作而成，全方位低温表面清洗，异向等离子体可以进入极细狭缝清洗。
AP 系列	AP-3P常压等离子清洗机	1.用途:对产品表面要求不高的FPC、PCB、手机零部件等表面有机物进行清洗，提高表面附着力。 2.主要参数:温度最低达55度;水滴角度最小可达10°。 3.产品特性:清洗适应性、适用广、使用方便活、可移动式等等等等优点，使气源等等等加速器，可以不需要空气或氮气;使用成本低。

(3)固化及智能组装设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件贴装和组装，如贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA 智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁螺丝、视觉检测等。ADA 智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
固化设备	红外固化	iCure-2/3/4红外固化炉系列	1.用途:用于热固胶水涂覆后的固化。 2.主要参数:可选配2至4个温区系统，温度精度可控制在±5℃。 3.产品特性:双层炉腔设计，降噪效果更佳;可拆卸式温区维护，便捷性;多段式独立控温，PID调节，节能高效。
	紫外固化	UV固化炉系列	1.用途:UV胶水涂覆或点胶后的固化。 2.主要参数:功率可调，灯管是设使用寿命可达长工作2000小时。 3.产品特性:自制光源及无频闪恒流技术，有效保证紫外线力稳定输出，大幅延长灯管寿命;多样性光源组合，汞灯、无极灯管/LED等可满足多种固化方式。
	热风固化	桌面热风固化系列	1.用途:手机背板及盖板(CCG与BG)的高效环保固化。 2.主要参数:上料4个加热板块，独立控温，温度从室温至130℃可任意设定。 3.产品特性:每个板块采用电阻丝加热，高温导流及风扇冷风，配有加热块及基流板;采用立式固化设计，极大节省空间。
智能组装及其他	全自动组装设备	OSA微型智能组装机系列	1.用途:用于医疗耗材、电子元件、玩具等产品的组装与锁付。 2.主要参数:工作宽度可在50-460mm范围内任意调节。 3.产品特性:采用整体铝合金焊接机架，结构稳定可靠，减少震动干扰性。
	上下料机	LD-460W供料系统	1.用途:用于医疗耗材、电子元件、玩具等产品的上料与下料。 2.主要参数:工作宽度可在50-460mm范围内任意调节。 3.产品特性:采用整体铝合金焊接机架，结构稳定可靠，减少震动干扰性。
	搬运设备	ADJ-460 自动搬运台	1.用途:用于SMT涂覆生产线、点胶生产线及产品组装生产线。 2.主要参数:工作宽度可在50-460mm范围内任意调节;可选0.5m、0.8m两种设备尺寸规格。 3.产品特性:采用整体铝合金焊接机架。
	ADA 智能平台 H 系列	龙门式	1.用途:多工艺模块装配平台型通用设备。 2.主要参数:XY 最大移动速度 1500mm/s，XY 重复定位精度±0.01mm。 3.产品特性:(1)结构设计一体并模块型;(2)整机装配成品，全动行程内三轴校正;(3)整个主机模组独立控制，可灵活拆卸，实现一站式作业，与 MES 系统连接;(4)整机采用标准化设计，实现整体快速装配;所有工艺模块都带有独立可编程控制器，可自动定位和识别;(5)所有工艺模块都有唯一的 IP 地址，快速实现插拔工艺模块自动识别，不同的工作头通过网络，自动运行相关程序及程序。
		桌面式	1.用途:多工艺模块装配平台型通用设备。 2.主要参数:XY 最大移动速度 1500mm/s，XY 重复定位精度±0.01mm。 3.产品特性:(1)结构设计一体并模块型;(2)整机装配成品，全动行程内三轴校正;(3)整个主机模组独立控制，可灵活拆卸，实现一站式作业，与 MES 系统连接;(4)整机采用标准化设计，实现整体快速装配;所有工艺模块都带有独立可编程控制器，可自动定位和识别;(5)所有工艺模块都有唯一的 IP 地址，快速实现插拔工艺模块自动识别，不同的工作头通过网络，自动运行相关程序及程序。

(4)配件及技术服务

技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等，贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

主要配件	典型产品图示	产品性能
点胶阀	气动柔射阀体JET-8600	1.用途:用于消费电子、照明行业、汽车工业等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC 封装胶、底部填充胶等工序环节。 2.主要参数: (1)采用气动式喷射阀设计，帕斯卡压可达 1-250,000mPa·s，能够满足大部分胶水的粘度要求; (2)采取压电驱动方式，可实现0.002毫升级别的精准点胶，点胶频率运行工作频率可达1000Hz，点胶直径线条宽度最小可精细到 0.3mm，最佳粘度范围可达 1,500,000mPa·s。 3、特点:单一机械部件可进行调整，可通性高;设计紧凑设计，充分降低噪音。
	PV-09A 压电喷射阀	
涂覆阀	涂覆阀体SA-W5	1.用途:用于消费电子、汽车工业等多领域的涂覆环节。 2 特点: (1)采用夹口式针头设计，零残留、无污染的可拆卸;涂覆厚涂层厚度可达10-200微米，100%固含量涂料厚度可达100-200微米; (2)采用弹形柔性阀结构设计，粘度范围0-3500cP·S，适用于低粘酸类、醇类、环氧类、UV胶等胶体的喷涂。

(5)柔性生产解决方案

除单一设备外，公司还可为客户提供应用于 PCBA 加工、3D 玻璃和手机组装等领域的柔性生产组合方案。以 PCBA 板涂覆解决方案为例：该生产线以 iCoat3 系列涂覆机为主体，配有自动升降机、接驳台、UV 检测台、UV 固化炉等装置；此外，PCBA 涂覆生产线还可选择双机(涂覆机)双炉等定制化方案。因涂覆所用胶体流动性相对高，成套生产线可减少胶体流动，最大程度保证加工工艺稳定性。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式，依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

2、采购模式

公司主要根据生产计划和研发需求，下达采购订单。此外，公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产，并依此提前采购一部分通用物料，以满足生产推产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主，此外还委托部分供应商进行部分五金件和机加件或电气件的简单加工，即外协加工模式，公司向其支付加工费。

3、生产模式

公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司为订单导向型，生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

4、研发模式

公司建立了研究院+研发中心+应用研发“三层”研发体系。其中，研究院牵头基础研发，主要负责基础模块建设、核心零部件研发；研发中心则负责基础平台搭建、软硬件平台整合；应用研发由各个事业部中心牵头，负责针对市场及客户对产品的工艺要求进行产品升级研发，解决客户现场的应用问题。

5、营销模式

公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势，实现了与全球头部电子信息产业客户及其 EMS 厂商的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其 EMS 厂商签订订单并发货，为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号)，属于“2.1 智能制造装备产业-3569 其他电子专用设备制造”。根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》，公司产品属于“2.1.4 智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。

(1)行业发展阶段

公司生产的流体控制设备属于电子专用设备制造行业和智能制造装备行业，智能制造装备行业是电子信息制造业实现自动化、智能化的必备条件和关键环节，而智能制造装备的技术水平更是下游制造业突破工艺和产能限制的关键技术瓶颈。电子信息制造业向高精度、小型化方向发展的速度加快，对生产工艺进步的速度提出了更高要求。技术进步带来的生产工艺变革，必将带来对智能制造装备的更新换代需求。但目前智能制造装备普遍存在定制化程度高的特征。因此，生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。

当前，制造业自动化面临四大行业痛点，即：自动化设备通用性低、故障排除时间长、操作门槛高、柔性化不足。以设备通用性为例，各类电子产品因生产工艺不同需使用专用电子设备；同一产品生产线因工序环节不同，亦需不同的生产设备进行生产。以上行业痛点，使得企业智能制造装备购置、人力资源培训、设备更新换代等成本较高，将成为制约电子信息制造业推动自动化和智能化升级的重要因素。

(2)行业基本特点

①关键核心零部件技术积累薄弱

核心零部件的结构设计和加工精度是影响智能制造装备技术水平的关键因素之一。但由于我国高端制造业起步较晚，对制造业上游的覆盖力尚显不足。根据信通院《中国工业经济发展形势展望(2020 年)》的数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在 50%以上。

而在当前贸易环境不确定性加剧的背景下，对海外供应商的核心基础零部件、关键基础材料等的依赖将成为我国制造业平稳健康发展的关键阻碍。虽然目前部分企业已开始针对性地进行核心零部件的研发，但在加工工艺和基础材料等方面，仍与全球领先技术存在较大差距，在部分高端制造业领域无法摆脱对外技术依存。

②高端制造领域的设备国产化程度有待提升

历经多年发展，我国自主研发和生产的各类智能制造装备已覆盖多种电子产品的多个工序环节，但在部分对技术参数要求更高、加工工艺精细度要求更高的制造业，国产智能制造装备的技术水平仍与国际领先企业存在差距。

(3)主要技术门槛

智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业，跨越多个学科和技术领域且更新迭代快，是下游终端制造业突破工艺和产能限